## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

## (11)特許出願公開番号 特開2001-249130

(P2001-249130A) (43)公開日 平成13年9月14日(2001.9.14)

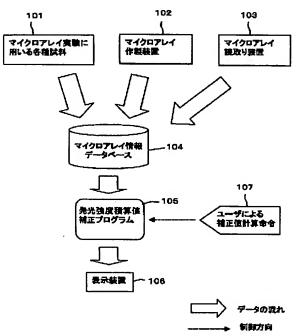
(51) Int. Cl. 7	識別記号	FI				テーマコート・	(参考)
GO1N 33/53		GO1N 33/53			M 2G058		
						4B024	
C12M 1/00		C12M 1/00	1/00		A	4B029	
C12N 15/09		C12Q 1/68	A 4B063				
C12Q 1/68		GO1N 33/56	66				
	審査請求	未請求 請求	項の数 5	OL	(全9	頁) 最終頁	ぼに続く
(21)出願番号	特願2000-60787 (P2000-60787)	(71)出願人	000233058	5			
		7 7	日立ソフ	トウエ	アエンシ	<b>ジニアリング</b>	株式会
(22) 出願日	平成12年3月6日(2000.3.6)		社			•	
			神奈川県	横浜市 <sup>。</sup>	中区尾」	上町6丁目81	番地
		(72)発明者	山本 知行	污			
			神奈川県	横浜市中	中区尾」	上町6丁目817	<b>野地</b>
			日立ソフ	トウエ	アエンシ	ジニアリング	朱式会
			社内				
		(74)代理人	100091096	3			
			弁理士 3	平木 礼	右輔	(外1名)	
			•				
						最終百	に続く

(54) 【発明の名称】マイクロアレイ、マイクロアレイ作製方法及びマイクロアレイにおけるピン間スポット量誤差補正 方法

## (57)【要約】

【課題】 複数のピンを用いたマイクロアレイの作製時に生じるピン間スポット量誤差を補償し、マイクロアレイ実験においてより正確なデータを取得する。

【解決手段】 マイクロアレイ作製時、ピン間スポット 量誤差補正コントロールとして用いる試料を全てのピン でマイクロアレイ支持体上へ固定化する。マイクロアレ イ実験後、その発光強度積算値を測定する。各ピン毎の ピン間スポット量誤差補正コントロールスポットとして 用いた試料の発光強度積算値から各ピン毎のピン間スポ ット量誤差補正パラメータを求め、他の試料の発光強度 積算値を補正するために利用する。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体上に複数の試料スポットを2次元アレイ状に配列したマイクロアレイにおいて、

前記複数の試料スポットのうち特定の位置関係を有する一群の試料スポットは、当該試料スポット群内での位置 関係と同じ相対的位置関係を有する複数の試料スポット によって構成される他の試料スポット群における試料スポット間のスポット量誤差を補正するために同一の試料 をスポットしたコントロールスポットであることを特徴 とするマイクロアレイ。

【請求項2】 請求項1記載のマイクロアレイにおいて、前記一群の試料スポットに属する試料スポットは相互に隣接していないことを特徴とするマイクロアレイ。 【請求項3】 複数のピンを備えるスポット手段を用い

て支持体上に複数の試料を同時にスポットする動作を反復し、支持体上に複数の試料スポットが2次元アレイ状に配列されたマイクロアレイを作製する方法において、前記スポット手段の全てのピンによって前記支持体上に同一試料を同時にスポットする工程を含むことを特徴とするマイクロアレイ作製方法。

【請求項4】 複数のピンを備えるスポット手段を用いて支持体上に複数の試料を同時にスポットする動作を反復して作製したマイクロアレイのピン間スポット量誤差を補正する方法において、

前記スポット手段で支持体上に複数の試料を同時にスポットする際に前記スポット手段の全てのピンによって前記支持体上に同一試料をコントロールとして同時にスポットする工程と、

前記スポット手段の各ピンによる前記コントロールのスポット量を測定してピン間スポット量誤差補正パラメー 30 タを求める工程と、

前記工程で求めたピン間スポット量誤差補正パラメータを用いて前記支持体上の各試料スポットに対する測定量を補正する工程とを含むことを特徴とするマイクロアレイのピン間スポット量誤差補正方法。

【請求項5】 請求項4記載のマイクロアレイのピン間スポット量誤差補正方法において、各試料スポットへの試料の固定に用いられたピンの識別情報を、当該ピンによってマイクロプレートに運ばれた試料が保持されていたウェルのウェルプレート内での位置情報を介して求め40ることを特徴とするマイクロアレイのピン間スポット量誤差補正方法。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、マイクロアレイ、 ピン方式のマイクロアレイ作製方法及びマイクロアレイ におけるピン間スポット量誤差補正方法に関する。

#### [0002]

【従来の技術】分子生物学や生化学の分野では、有用な 遺伝子の探索や病気の診断などのために生体内の核酸や 50 タンパク質などの生体高分子を同定・分画することが行われ、その際の前処理として、既知の配列をもつ核酸やタンパク質と試料中のターゲット分子とをハイブリダイズさせるハイブリダイゼーション反応が多用されている。このため、既知の配列をもつDNA、RNA、タンパク質などのプローブを所定位置に固定しておくバイオチップやDNAチップと呼ばれるマイクロアレイが用いられている。

【0003】マイクロアレイ上にはフィーチャーと呼ばれる多数の領域が画定され、各フィーチャーにはそれぞれ異なるプローブが固定されている。このマイクロアレイを試料DNA等と共に反応容器の中に入れ、反応容器内でマイクロアレイの各フィーチャーに結合させたプローブと蛍光標識した試料DNAとのハイブリダイゼーションを行う。その後、マイクロアレイに励起光を照射し、各フィーチャーから発せられる蛍光強度を測定することによって各プローブと試料DNAとの結合量を知り、それを必要な情報に変換する。

【0004】現在、マイクロアレイの作製方法には大きく分けて、マイクロアレイ支持体上でオリゴヌクレオチドを合成する方法とマイクロアレイ支持体上にcDNAなどの試料をスポットして固定化していく方法の二種がある。そのうち後者のマイクロアレイ作製方法においては、試料が保存されているウェルプレートの各ウェルから試料を取得しマイクロアレイ支持体上に固定化するためにピンを使用する方法が広く用いられており、また、マイクロアレイの作製を高速化するために、複数のピンを同時に使用する方法が用いられている。多くのマイクロアレイ実験においては、スポット間の定量的な差を測定することが必要であるため、同時に使用される複数のピンの間でスポット量に誤差が生じない様、均一なピンの製造、及びピンの装置への正確な取り付けには細心の注意が払われている。

## [0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、より高速なマイクロアレイ作製を行うために、同時に使用するピン数を増加した場合、均一なピンの製造、及びピンの装置への正確な取り付けによるピン間のスポット量の均一化(ハード的手法)が難しくなってきている。

【0006】本発明は、このような問題点に鑑み、ピン間のスポット量に個体差があったとしても測定結果に影響が及ぶことのないマイクロアレイ、マイクロアレイ作製方法及びマイクロアレイにおけるピン間スポット量誤差補正方法を提供することを目的とする。

### [0007]

【課題を解決するための手段】本発明では、ソフト的手法によって前記目的を達成する。すなわち、マイクロアレイ作製時に固定化する試料の一部として、同一の試料を、同時に使用される全てのピンでスポットしたものをコントロールスポット(ピン間誤差補正コントロールス

4

ポット)とし、マイクロアレイ読み取り装置を用いてピン間誤差補正コントロールスポットの発光強度積算値を 測定し、スポット量の誤差情報を得る。得られたスポット量の誤差より、各ピン毎のピン間誤差補正パラメータを求め、マイクロアレイ読み取り装置を用いて測定された同じマイクロアレイ上のスポットの発光強度積算値を 補正することにより各スポットにおける測定値の補正値を求める。

【0008】各スポットの発光強度積算値を補正するためには、各スポットが、どのピンによりスポットされた 10かを特定する必要がある。本発明では、マイクロアレイ作製時に、各スポットに固定された試料が、試料を保存していたウェルプレートのどのウェル(座標位置)に存在したかの情報を保存するデータベース、及び結果としてどのピンでその試料がスポットされたかを追跡するためのプログラムを用意する。

【0009】すなわち、本発明によるマイクロアレイは、支持体上に複数の試料スポットを2次元アレイ状に配列したマイクロアレイにおいて、複数の試料スポットのうち特定の位置関係を有する一群の試料スポットは、当該試料スポット群内での位置関係と同じ相対的位置関係を有する複数の試料スポットによって構成される他の試料スポット群における試料スポット間のスポット量誤差を補正するために同一の試料をスポットしたコントロールスポットであることを特徴とする。

【0010】前記一群の試料スポットに属する試料スポットは相互に隣接していないスポットとすることができる。マイクロアレイに、スポット手段に備えられている複数のピンのピン間隔より小さなピッチで試料スポットを固定する場合、コントロールスポットはマイクロアレ 30 イ上で飛び飛びの位置を占めることになる。

【0011】本発明によるマイクロアレイ作製方法は、 複数のピンを備えるスポット手段を用いて支持体上に複 数の試料を同時にスポットする動作を反復し、支持体上 に複数の試料スポットが2次元アレイ状に配列されたマ イクロアレイを作製する方法において、スポット手段の 全てのピンによって支持体上に同一試料を同時にスポットする工程を含むことを特徴とする。スポット手段の全 てのピンによって同時にスポットされた同一試料は、スポット手段の複数のピンの個体差により生じるピン間ス 40 ポット量誤差を測定するためのコントロールスポットと して機能する。

【0012】本発明によるマイクロアレイのピン間スポット量誤差補正方法は、複数のピンを備えるスポット手段を用いて支持体上に複数の試料を同時にスポットする動作を反復して作製したマイクロアレイのピン間スポット量誤差を補正する方法において、スポット手段で支持体上に複数の試料を同時にスポットする際にスポット手段の全てのピンによって支持体上に同一試料をコントロールとして同時にスポットする工程と、スポット手段の50

各ピンによるコントロールのスポット量を測定してピン間スポット量誤差補正パラメータを求める工程と、前記工程で求めたピン間スポット量誤差補正パラメータを用いて支持体上の各試料スポットに対する測定量を補正する工程とを含むことを特徴とする。

【0013】スポット手段の各ピンによるコントロールのスポット量の測定は、サンプルとのハイブリダイゼーション反応を行った後に実行することもできるし、ハイブリダイゼーション反応を行う前に実行することもできる。ハイブリダイゼーション反応を行った後にコントロールのスポット量を測定する場合には、例えばコントロールにハイブリダイズした蛍光標識試料からの発光強度積算値を測定して、それをコントロールのスポット量とすればよい。一方、ハイブリダイゼーション反応を行う前にコントロールのスポット量を測定する場合には、コントロールのスポット量を測定する場合には、コントロール中に例えば一定濃度の蛍光物質を含有させておき、その蛍光物質からの発光強度積算値を測定して、それをコントロールのスポット量とすればよい。

【0014】上記マイクロアレイのピン間スポット量誤 差補正方法において、各試料スポットへの試料の固定に 用いられたピンの識別情報は、当該ピンによってマイクロプレートに運ばれた試料が保持されていたウェルのウェルプレート内での位置情報を介して求めることができる。

## [0015]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実施の形態を説明する。ここでは説明を簡単にするために4本のピンを有するスポット手段を用いる例によって説明するが、4本以上のピンを有するスポット手段を用いてマイクロアレイを作製する場合にも同様に本発明が適用可能であるのは勿論である。

【0016】図1に、本発明によるマイクロアレイを用 いた測定の概要を示す。マイクロアレイを用いた実験に おいて、各種試料の調整101からマイクロアレイの作 製102、そしてマイクロアレイの読み取り103まで の過程で得られる試料データ、マイクロアレイ作製デー タ、そしてマイクロアレイデータなど様々なデータはそ れぞれマイクロアレイ情報データベース104へ格納さ れる。データベース104中のデータは、各種試料を識 別するものとして利用されるとともに、試料が格納され ていたウェルプレートのどの位置に存在したか、及び結 果としてどのピンでその試料がマイクロアレイ上にスポ ットされたかを追跡するためのデータとしても利用され る。各スポットの発光強度積算値の補正値計算命令10 7が実行されると発光強度積算値補正プログラム105 が起動し、マイクロアレイ情報データベース104から 取得した情報をもとに各スポットの発光強度積算値の補 正値を計算し、結果を表示装置106へ表示する。マイ クロアレイ情報データベース104、発光強度積算値補 正プログラム105、表示装置106の表示等の詳細は

以下に説明する。

【0017】図2は、マイクロアレイ実験に用いるために調整した試料201~205をウェルプレート214~分注する過程を示した概略図である。試料201~205はマイクロアレイに固定される試料であり、それぞれの試料は各エッペンチューブに分注されている。試料201はピン間スポット量誤差補正コントロールとして用いるために調整した試料であり、試料202から試料205まではマイクロアレイを用いて調べたい試料Sample1からSample4である。各スポットの発光強度積算値の補正値を求めるためには、ピン間スポット量誤差補正コントロールとして用いる試料201を他の試料と同様に準備しておく必要がある。

【0018】図2に破線の矢印で示すように、エッペンチューブ内の試料201はウェルプレート214上のウェル206~209へ、試料202はウェル210へ、試料203はウェル211へ、試料204はウェル212へ、そして試料205はウェル213へそれぞれ分注される。ここで、ピン間スポット量誤差補正コントロールとして用いる試料201については、マイクロアレイ20への固定に用いるスポット手段の複数のピン全でが一度に試料を取得できるような位置関係にあるウェルに分注する必要がある。この過程において、試料202~205そのものの情報や、どの試料がウェルプレート214上のどのウェルに分注されたか等の情報が得られる。得られた情報はサンプルスポット情報としてマイクロアレイ情報データベース104に格納される。

【0019】図3は、4本のピンを持つスポット手段を用いて、ウェルプレート上の各ウェルより試料をマイクロアレイ上に固定する過程を表わした概念図である。ス 30ポット手段301は4本のピンを有し、ウェルプレート302a,302b,…より一度に4種類の試料を4本のピンに取得することができるので、マイクロアレイ支持体303上に一度のスポット動作で4つのスポットを同時に固定することができる。図3(a)に示すように、スポット手段301の4本のピンの先をウェルプレート302aの試料が入ったウェルに浸し、各ピンに試料を付着させる。次に、図3(b)に示すように、スポット手段301の試料が付着したピンの先端をマイクロアレイ303の指定された座標位置に接触させること 40で、各ピンに付着していた試料がマイクロプレートに移り、そこに試料スポットが形成され固定される。

【0020】この過程において得られるマイクロアレイ作製に用いたピン等についての情報は、マイクロアレイ情報としてマイクロアレイ情報データベース104に保存される。なお、マイクロアレイ作製装置に依存して試料を固定するピンの動作は多様であるため、ここでは試料のウェルプレート302a,302b,…上での位置とマイクロアレイ303上での位置の対応づけの方法は記さないが、それぞれの対応は取れているものとす

る。

【0021】図4は、マイクロアレイ読み取り装置40 2を用いて、作製したマイクロアレイ401上の各スポ ットの発光強度積算値、及びマイクロアレイ401自身 のバックグラウンドの発光強度積算値を読み取る過程を 模式的に示したものである。マイクロアレイに固定化さ れた試料に対して既知の方法で蛍光標識試料をハイブリ ダイズさせる。その後、マイクロアレイ401を読み取 り装置402の下方に置き、励起光源403からの励起 光を照射して蛍光標識からの発光を二次元光センサー4 04で読み取る。このとき、二次元光センサー404の 光路中にはランプ403からの励起光を通さず、蛍光標 識からの発光を透過する光学フィルター405を配置す る。読み取った各スポットの発光強度積算値のデータや スポット間のバックグラウンド値の情報はコントローラ 406を介してコンピュータ407に取り込まれる。マ イクロアレイ読み取り装置402を用いてマイクロアレ イ情報を読み取る過程において得られる各スポットの発 光強度積算値の情報やマイクロアレイのバックグラウン ド値の情報など様々な情報は、サンプルスポット情報及 びマイクロアレイ情報としてマイクロアレイ情報データ ベース104に格納される。

6

【0022】図5は、マイクロアレイ情報データベース104の構成の一例を示す図である。図5(a)に示した表はマイクロアレイに関する情報を持つレコードの例であり、マイクロアレイのID501、マイクロアレイのバックグラウンド値502、マイクロアレイの定義503、マイクロアレイ作製に用いたピンのタイプ504などのフィールドを持つ。また、図5(b)に示した表はマイクロアレイ上に固定されたスポットの情報を持つレコードの例であり、スポットID505、マイクロアレイ情報へのポインター(マイクロアレイID)506、試料の名前507、定義情報508、発光強度積算値509、そしてウェルプレート上でのウェルの位置情報600,601などのフィールドを持つ。

【0023】これらのデータをもとにして、1つのスポット手段301に複数存在するピン(いまの例の場合、4本のピン)の中からそれぞれのスポット位置に試料を固定するのに用いたピンを特定し、各ピン毎にピン間スポット量誤差補正パラメータを求める。求めたピン間スポット量誤差補正パラメータを用いて各スポットの発光強度積算値の補正値を求めるための計算を行う。以下に、その方法について説明する。

【0024】図6は、各スポットの発光強度積算値の補 正値を求めるために用いる発光強度積算値補正プログラム105の処理手順の概要を示すフローチャートであ る。このプログラムが起動されると、初めにピン間スポット量誤差補正コントロールとして用いられた試料を特定する。そして、その試料の発光強度積算値やウェルの 50 座標情報、マイクロアレイへの固定に用いたピンタイプ

についての情報をマイクロアレイ情報データベース10 4より取得する(S601)。ここでの例の場合、図5 (b) のサンプルスポット情報から、スポット I Dが S S1からSS4の4個のスポットがコントロール試料で あること、各コントロール試料の発光強度積算値は45 00,4600,4400,4700であること、各コ ントロール試料が入っていたウェルのXY座標は(1, 1)、(1, 2)、(2, 1)、(2, 2)であること を知る。また、図5 (a) のマイクロアレイ情報から、 マイクロアレイ I DがMA 1 であるマイクロアレイのピ 10

> ウェル中のx座標 ピンのx軸方向の本数

## ウェル中のy座標 ピンのy軸方向の本数

X':Xの小数第一位が0でないとき、一の位を一つ繰り上げた整数

Y':Yの小数第一位が0でないとき、一の位を一つ繰り上げた整数

[0027]

【数 2 】ピン特定変数A=ウェル中の x 座標ー (X′ー 1)×ピンのx軸方向の本数

ピン特定変数B=ウェル中のy座標-  $(Y'-1) \times ピ$ ンのv軸方向の本数

【0028】上記〔数1〕〔数2〕は、各試料が、スポ ット手段301が複数備えるピンのうちどのピンにより マイクロアレイ上に固定されたかを示すピン特定変数を 求めるための計算式である。〔数1〕では、複数ピンに より一度に取得される試料が保存されたウェルの範囲を 1ブロックとし、各ウェルがX軸方向に何ブロック目に 位置するか、Y軸方向に何ブロック目に位置するかを求 める。〔数2〕ではX軸, Y軸とも〔数1〕で求めた該 30 当ブロックの左方向と上方向にあるブロックを削除した 状態でウェルのx座標、及びy座標を求める。そうする ことで求めたx座標、y座標は常に1ブロック内での座 標となる。つまり、1ブロックはピンが一度に取得する ことができる試料を保存したウェルの範囲であるので、 求めた座標はピンのx座標、y座標と対応することにな

ンタイプは2×2であること、バックグラウンド値は1 00であることを知る。

【0025】次に、取得したウェルの座標情報、ピンタ イプの情報から次の〔数1〕〔数2〕によって求められ るピン特定変数 (A, B) の組によって、ピン間スポッ ト量誤差補正コントロールとして用いた試料をマイクロ アレイ上に固定したピンを特定する(S602)。

[0026]

【数1】

る。求めたx座標、y座標をピン特定変数として用いる ことにより各ウェル中の試料がいずれのピンによりマイ クロアレイ上に固定されたかを特定することができる。 図3に示す配置の場合、上記〔数1〕及び〔数2〕によ って計算されるピン特定変数 (A, B) は { (1, 1), (2, 1), (1, 2), (2, 2)}の4種類 となる。

【0029】次に、一つのスポット手段301に複数存 在するピン(A, B)毎のピン間スポット量誤差補正パ ラメータC.P.(A, B)を求める。このために先に求めた ピン毎のピン特定変数、ピン間スポット量誤差補正コン トロールとして用いた試料の発光強度積算値、そしてマ イクロアレイのバックグラウンド値BGを用いる(S60 3)。ピン特定変数(A, B)で特定されるピンに対す るピン間スポット量誤差補正パラメータC.P.(A. B) は、次の〔数3〕で求められる。

[0030]

【数3】

## コントロールの発光強度積算値の平均値 $C.P.(A,B) = \frac{}{\mathsf{U} \mathsf{V} \cdot (\mathsf{A},\;\mathsf{B})} \, \mathcal{O}$ コントロールの発光強度積算値-BG

【0031】ここで、〔数3〕の被除数であるコントロ 光強度積算値の和を全コントロール数で除算し、その値 からマイクロアレイのバックグラウンド値BGを減算した ものである。こうして、4本のピンに対するピン間スポ ット量誤差補正パラメータC.P. (1, 1), C.P. (2, 1), C.P. (1, 2), C.P. (2, 2) が求まる。次 に、マイクロアレイ情報データベースより、補正値を求 めたい試料の発光強度積算値、ウェルプレート上でのウ エルの座標情報を取得する(S604)。

【0032】そして、求めたい試料のウェルの座標情 報、ピンタイプの情報から、前記〔数1〕〔数2〕によ 50

りその試料をスポットしたピンのピン特定変数 (A, ールの発光強度積算値の平均値は、全コントロールの発 40 B)を求める。ピン特定変数が同じ試料スポットは、同 じピンでスポットされた試料である。こうして、マイク ロアレイ上にその試料をスポットしたピンを特定するこ とができる(S605)。そして、試料を固定したピン のピン間スポット量誤差補正パラメータC.P.(A, B)を 用いて、次の〔数4〕により補正された発光強度積算値 (補正値)を算出する(S606)。

[0033]

【数4】

補正値=C.P.(A, B)× (試料の発光強度積算値-BG) 【0034】発光強度積算値の補正値を求めたい試料が

複数ある場合は、ステップ607において全ての試料に 対する補正値の算出が完了したと判定されるまで、ステ ップ604より同じステップを繰り返す。最後に、求め た各試料の発光強度積算値の補正値を画面上に表示する (S608),

【0035】画面の表示例を図7に示す。図7(a)に 示した発光強度積算値の補正値表示画面701には、試 料の名称、その試料が複数あるピンのいずれにより固定 されたか、試料の発光強度積算値の実測値、その補正 値、及びピン毎のピン間スポット量誤差補正パラメータ 10 等の情報を表示する。図7 (b) に示すように、補正値 表示画面701のメニュー702の編集メニューより選 択表示あるいは並び替えを選択することで、図7 (c) のように選択表示ダイアログボックス703あるいは並 び替えダイアログボックス704を開くことができる。 これらのダイアログを操作することにより、補正値表示 画面701により表示されるデータを操作することがで きる。

【0036】なお、上記の説明ではマイクロアレイを用 クロアレイのピン間スポット量誤差補正パラメータC.P. (A, B)を求めたが、コントロール試料の中に予め蛍光 物質を含ませておき、試料をスポットした後ハイブリダ イゼーション反応を行う前にコントロールスポットの発 光強度積算値を測定してピン間スポット量誤差補正パラ メータC.P.(A, B)を求めるようにしてもよい。

## [0037]

【発明の効果】本発明によると、マイクロアレイ作製時 にピンの個体差により生じるピン間のスポット量の誤差 に起因する発光強度測定値の誤差を補正することがで き、ハードの品質に左右されない測定結果を得ることが 可能になる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるマイクロアレイを用いた測定の概 要を示す図。

10

【図2】試料をウェルプレートへ分注する過程を示した 概略図。

【図3】複数のピンを持つスポット手段を用いたマイク ロアレイの作製方法の説明図。

【図4】マイクロアレイ読み取り装置の概略図。

【図5】マイクロアレイ情報データベースの構造とデー タの例を示す図。

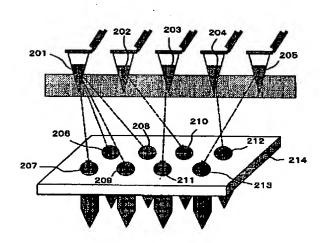
【図6】発光強度積算値補正プログラムの処理手順の概 要を示すフローチャート。

【図7】発光強度積算値の補正値を表示する表示画面の 例を示す図。

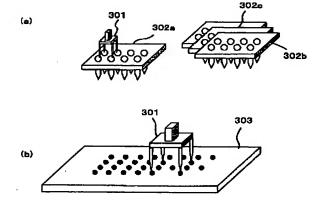
## 【符号の説明】

201…ピン間スポット量誤差補正コントロールとして 用いる試料、202~205…マイクロアレイ実験に用 いる試料、206~209…ピン間スポット量誤差補正 いたハイブリダイゼーション反応を行った後にそのマイ 20 コントロールとして用いる試料を保有するウェル、21 0~2113…試料を保有するウェル、214…ウェル プレート、301…スポット手段、302a~302c …ウェルプレート、303…マイクロアレイ支持体、4 01…マイクロアレイ、402…マイクロアレイ読み取 り装置、403…励起光源、404…二次元光センサ 一、405…光学フィルター、406…コントローラ、 407…コンピュータ、701…発光強度積算値の補正 値表示画面、702…補正値表示画面のメニュー、70 3…選択表示ダイアログボックス、704…並び替えダ 30 イアログボックス

【図2】



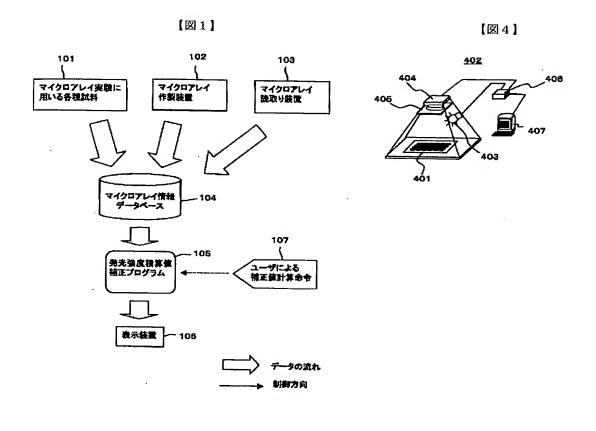
【図3】



(a)

(P)

(c)

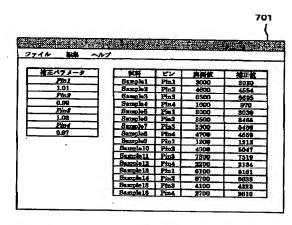


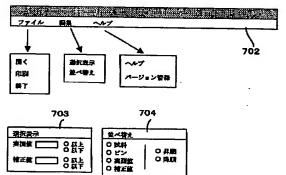


【図5】

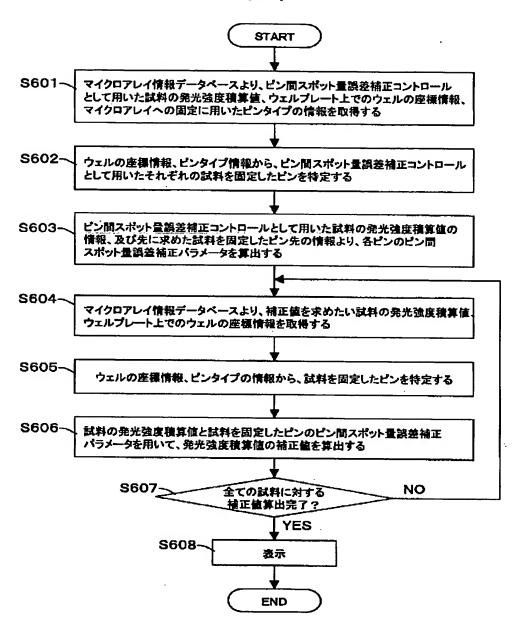












フロントページ	の続き
---------	-----

(51) Int. Cl.	7	識別記号		FΙ				テーマコート・	(参考)
G01N 3	33/566		,		35/02		F		
3	35/02				1/00	101	Н		
3	35/10				•	101	K		
// GO1N	1/00	101		C12N	15/00		Α		
				G01N	35/06		J		

(72)発明者 田村 卓郎

神奈川県横浜市中区尾上町6丁目81番地 日立ソフトウエアエンジニアリング株式会 社内

F ターム(参考) 2G058 AA09 CA01 CC02 EA02 EA11

ED20 ED21 GB10 GD01 HA00

4B024 AA11 CA02 CA09 HA12

4B029 AA07 BB20 CC03 FA12

4B063 QA01 QA08 QA18 QA19 QQ42

QR32 QR66 QS36 QS39 QX02